



開発品

低温熱圧着 導電シート



- 熱圧着 導電性銀ペーストをシート化
- 従来の導電性粘着テープより低抵抗
- PET、PEN、PI、ポリカなどへの密着性が良好



接着剤の
塗布 & 硬化
不要!

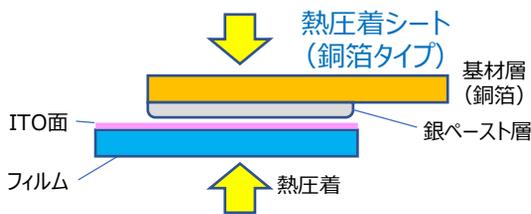
想定される用途

- ✓ 透明導電性フィルムを使用するデバイス
- ✓ はんだ付けができない熱に弱い部材
- ✓ 調光フィルム、有機薄膜太陽電池、透明アンテナ、透明ヒーターなど

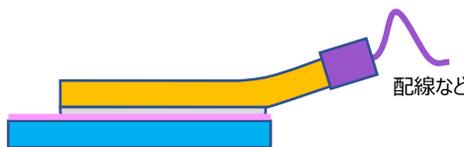
【使用例】透明導電性フィルム (ITO蒸着) からの端子取り出し

～銅箔タイプを使用する場合～

- 熱圧着シート (銅箔タイプ) を直接ITO面に接着



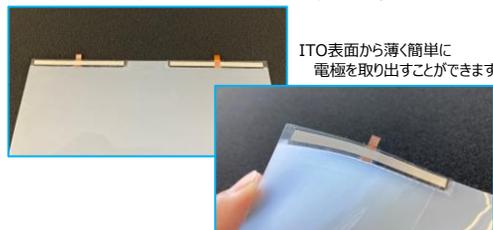
- 銅箔に配線を取り付け容易に電気接続ができる



[組み立て事例]

調光フィルム:

ITO蒸着PETフィルム表面に銅端子を熱圧着で接続。
従来のはんだ付けより厚みを半減 (-56%) できた。



[接着強度]

剥離強度:
10 N/25mm (凝集破壊)



[熱圧着導電シート 一般性状]

(開発品のため参考データ)

| | |
|--------|---|
| 導電フィラー | 銀 |
| 樹脂 | ポリエステル系熱可塑性樹脂 |
| 体積抵抗率 | $2 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ |
| 圧着条件 | 80°C 0.1Mpa 30秒 ※圧着条件は被着体や材質により異なります |
| 基材層 | 銅 (50μm) またはPET(100μm) |